

第52期 中間報告書

平成26年4月1日から
平成26年9月30日まで



東京エレクトロン株式会社

株主の皆さまへ



代表取締役会長 兼 社長 CEO
東 哲郎

目次

株主の皆さまへ	1
■ 事業の概況	2
■ 主要な事業内容及びセグメント別の概況	3
■ 株式の状況	5
■ 特集 半導体(IC)／ TFT-LCD製造プロセス	7
■ 連結財務諸表	9
■ 会社の概況等	12
株主メモ	13

株主の皆さまには、平素より格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

第52期中間期（平成26年4月1日から平成26年9月30日まで）報告書として、事業の概況等をご報告するにあたり、ご挨拶申し上げます。

第52期中間期の連結業績は売上高、利益ともに期初からの想定を上回ることができました。これもひとえに、株主の皆さまのご支援とご理解の賜物と感謝しております。

当社は、平成25年9月に米国Applied Materials, Inc.との経営統合に合意しました。平成26年7月に新会社名「Eteris（エタリス）」を発表するなど、お互いの企業文化の強みを融合する事業運営の統合準備は、順調に進展しております。

重要な変革点を迎えている半導体関連業界において、株主の皆さまをはじめとする世界中のステークホルダーの皆さまの信頼と期待にお応えすべく、今後も、技術革新に常に挑戦するとともに、透明性の高い経営を維持・強化し、より大きな価値を創造することで、持続的な成長を図ってまいります。

株主の皆さまにおかれましては一層のご支援とご理解を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

平成26年11月

事業の概況

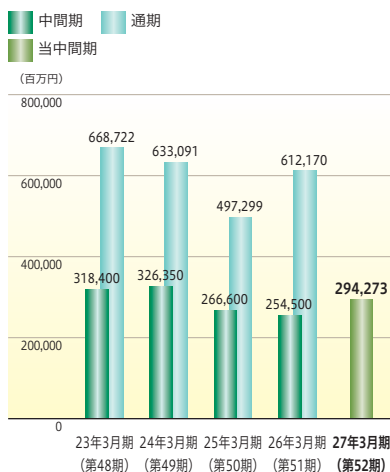
当中間期におきましては、世界経済は総じて緩やかな回復基調が続いております。また、日本におきましては消費税率引き上げの影響があったものの、景気は概ね緩やかな回復を示しております。

当社グループの参画しておりますエレクトロニクス産業におきましては、新型スマートフォン発売による半導体需要や、中国をはじめとする低価格帯のスマートフォン市場の拡大がみられ、また、クラウドコンピューティングの普及やビッグデータ活用の拡がりを受けて

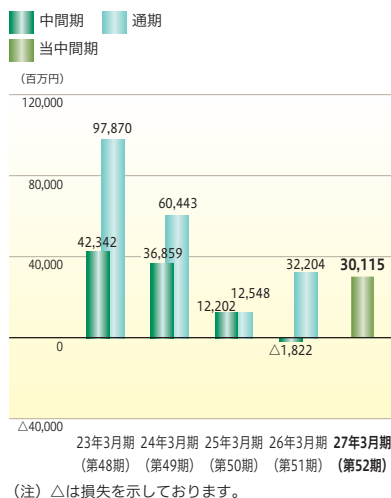
データセンター向けサーバー需要が伸びる等、電子部品市場は引き続き堅調に推移しております。

このような状況のもと、当社グループの当中間期の連結業績は、売上高2,942億7千3百万円（前年同期比15.6%増）、営業利益301億1千5百万円（前年同期は18億2千2百万円の営業損失）、経常利益317億7千3百万円（前年同期は5億8千8百万円の経常利益）、また、当期純利益は200億1千6百万円（前年同期比708.2%増）となりました。

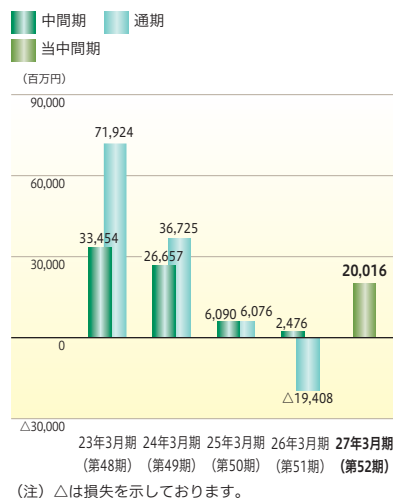
連結売上高



連結営業利益



連結当期純利益



(注) 当社は本年4月及び5月に東京エレクトロニクス株式会社の一部を売却いたしました。これにより、当社が当社の連結子会社から持分法適用関連会社へ異動し、第1四半期連結会計期間から、当社及びその子会社が担っていた「電子部品・情報通信機器」を報告セグメントから除外いたしました。連結売上高（2,942億7千3百万円）及び前年同期比増減率（15.6%増）につきましては、当社を連結の範囲から除外した影響が反映されたものであります。

主要な事業内容及びセグメント別の概況

当社グループは、エレクトロニクス技術を利用した半導体製造装置及びFPD（フラットパネルディスプレイ）の製造・販売を事業の中心としております。

半導体製造装置

■ 事業の状況

スマートフォンの高機能化と堅調な販売、データセンター向けサーバー需要などを背景に、DRAMやNANDフラッシュメモリー等の電子部品の需要は好調であり、半導体メーカーの設備投資は順調に推移しました。このような状況のもと、当セグメントの当中間期の外部顧客に対する売上高は、2,726億2千6百万円（前年同期比40.0%増）となりました。

■ 主要営業品目

- コータ/デベロッパ
- プラズマエッチング装置
- 熱処理成膜装置
- 枚葉成膜装置
- 洗浄装置
- ウェーハブローバ

コータ/デベロッパ
CLEAN TRACK™ LITHIUS Pro™ Z



プラズマエッチング装置
Tactras™



ALD成膜装置
NT333™



枚葉CVD装置
Triase+™



枚葉洗浄装置
CELLESTA™-i



ウェーハブローバ
Precio nano™



FPD（フラットパネルディスプレイ）製造装置

■ 事業の状況

スマートフォン向けを中心とした中小型液晶パネル需要に加え、中国における大型液晶パネル向け設備投資も続いており、FPD製造装置市場は引き続き堅調でした。このような状況のもと、当セグメントの当中間期の外部顧客に対する売上高は、190億2千9百万円（前年同期比102.6%増）となりました。

■ 主要営業品目

- FPDコータ
- FPDプラズマエッチング／アッシング装置

FPDプラズマエッチング／
アッシング装置
Impressio™



PV（太陽光パネル）製造装置

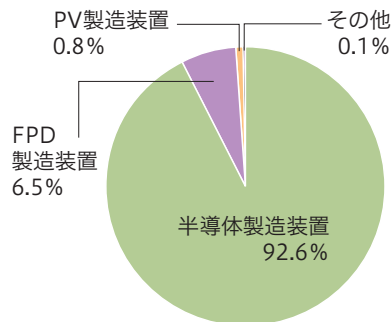
■ 事業の状況

太陽光パネル製造装置の新規販売活動の撤退を決定しておりますが、受済み装置に対する工事進行基準による売上高等の計上により、当セグメントの当中間期の外部顧客に対する売上高は、23億2千5百万円（前年同期比29.3%減）となりました。

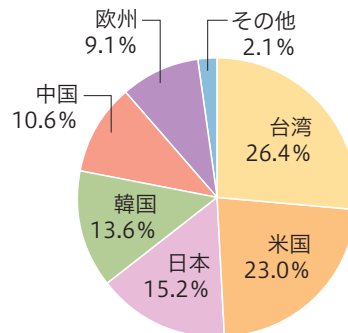
その他

上記3セグメントに含まれない事業における当中間期の外部顧客に対する売上高は、2億9千2百万円（前年同期比13.2%増）となりました。

■ 連結 セグメント別売上構成比（当中間期）



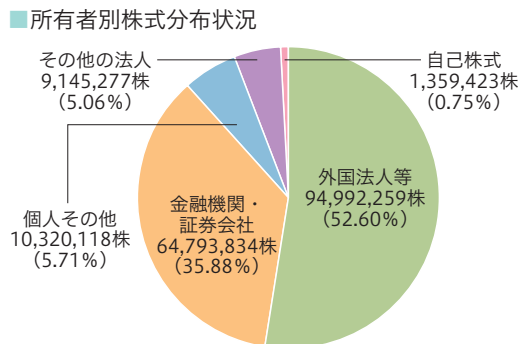
■ 連結 地域別売上構成比（当中間期）



(注) 当社は本年4月及び5月に東京エレクトロン デバイス株式会社の一部を売却いたしました。これにより、当社が当社の連結子会社から持分法適用関連会社へ異動し、第1四半期連結会計期間から、当社及びその子会社が担っていた「電子部品・情報通信機器」を報告セグメントから除外いたしました。

株式の状況 (平成26年9月30日現在)

発行可能株式総数 300,000,000株
 発行済株式の総数 180,610,911株
 株主数 23,625名



大株主の状況

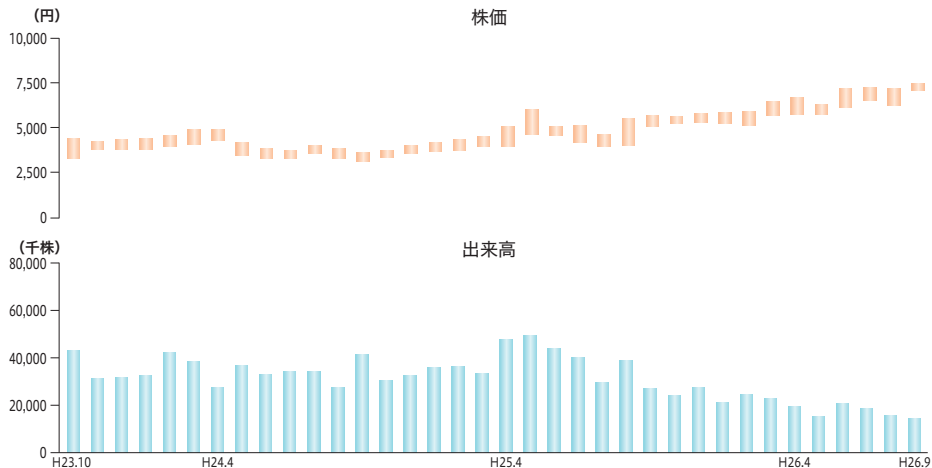
株主名	持株数 (千株)	持株比率 (%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	19,024	10.61
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	10,972	6.12
ザ バンク オブ ニューヨーク メロン アズ デポジタリー バンク フォー デポジタリー レシート ホルダーズ	10,410	5.80
ドイチェバンクトラストカンパニーアメリカズ	8,437	4.70
株式会社東京放送ホールディングス	7,727	4.31
MSIP CLIENT SECURITIES	5,632	3.14
BNPパリバ証券株式会社	3,583	1.99
ザ バンク オブ ニューヨーク メロン エヌイー エヌブイ 10	3,015	1.68
ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント	2,247	1.25
資産管理サービス信託銀行株式会社 (証券投資信託口)	2,219	1.23

(注) 1. 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

2. 持株比率は、自己株式 (1,359,423株) を控除して算出しております。また、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

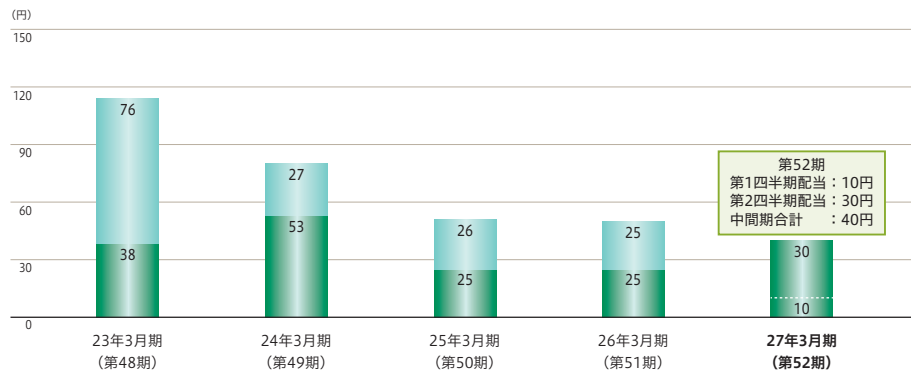
3. 株式会社三菱東京UFJ銀行及びその共同保有者である他3社から平成26年9月30日付で関東財務局長に提出された変更報告書により平成26年9月22日現在、13,827千株所有している旨、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者である他2社から平成24年9月21日付で関東財務局長に提出された変更報告書により平成24年9月14日現在、11,361千株所有している旨、野村證券株式会社及びその共同保有者である他2社から平成26年2月21日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書により平成26年2月14日現在、9,199千株所有している旨、モルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社及びその共同保有者である他4社から平成26年6月19日付で関東財務局長に提出された変更報告書により平成26年6月13日現在、8,854千株所有している旨の報告を受けておりますが、当社として平成26年9月30日現在の実質保有状況の確認ができない部分については、上記表に含めておりません。

株価と出来高 (平成23年10月～平成26年9月)



配当金の推移

■ 中間配当 ■ 期末配当

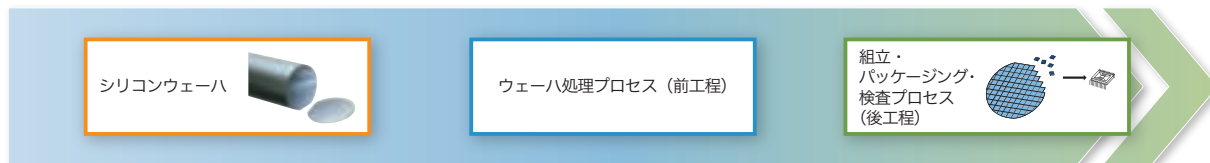


(注) 平成23年3月期期末配当から、連結当期純利益に対する配当性向の目標を20%から35%に変更しております。

特集 半導体（IC）／TFT-LCD製造プロセス

半導体（IC）製造プロセス

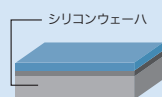
半導体は、シリコンウェーハ上に金属や絶縁体の薄膜を重ねあわせ、回路を形成したものです。半導体の製造プロセスは、回路を形成する前工程と組立・パッケージング・検査を行う後工程の二つに分かれます。



ウェーハ処理プロセス（前工程）

当社グループの提供する装置の多くが前工程で使用されており、世界で高い評価を獲得しています。

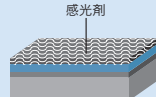
酸化膜形成、窒化膜形成



シリコン酸化膜を化学的に成長させた後、シリコン窒化膜を堆積させる

熱処理成膜装置

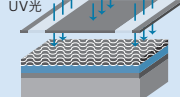
感光剤塗布



感光剤をウェーハ全面に均一に塗布する

コータ/デベロッパ

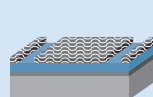
露光



UV光を当て、感光剤上にIC回路を転写する

パターン形成

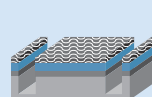
現像



IC回路パターンをウェーハ上に作り出す

コータ/デベロッパ

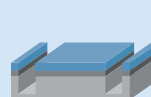
エッチング



ウェーハ上のパターンに従って、対象膜を化学反応により加工・除去する

プラズマエッチング装置

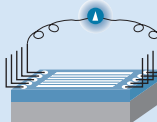
感光剤剥離・洗浄



エッチング後の感光剤を除去した後、薬液に浸し、不純物を除去する

洗浄装置

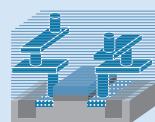
ウェーハ検査



でき上がったICチップを検査する

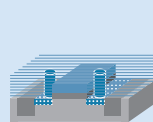
ウェーハプローバ

多層配線形成



多層配線間絶縁膜を形成し、配線層を作り個々のトランジスタを接続する

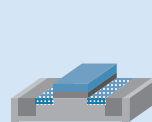
配線用ホール形成



酸化膜を堆積させ表面を平坦にする。配線用ホールを開口し、金属膜を埋め込む

プラズマエッチング装置

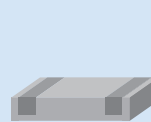
電極形成



不純物注入後に均一に拡散させ、トランジスタの電極を形成する

熱処理装置

素子分離形成

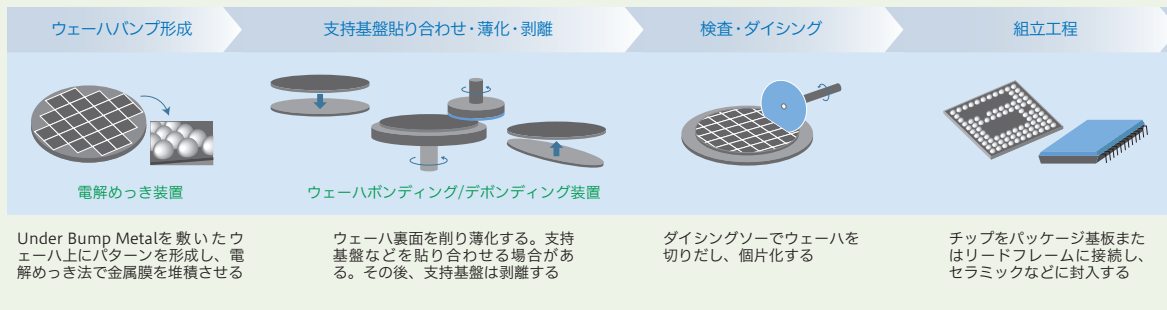


酸化膜を堆積させ、ウェーハ上に形成した溝に埋め込む。膜の表面を研磨し、平坦にする

CVD装置

組立・パッケージング・検査プロセス（後工程）

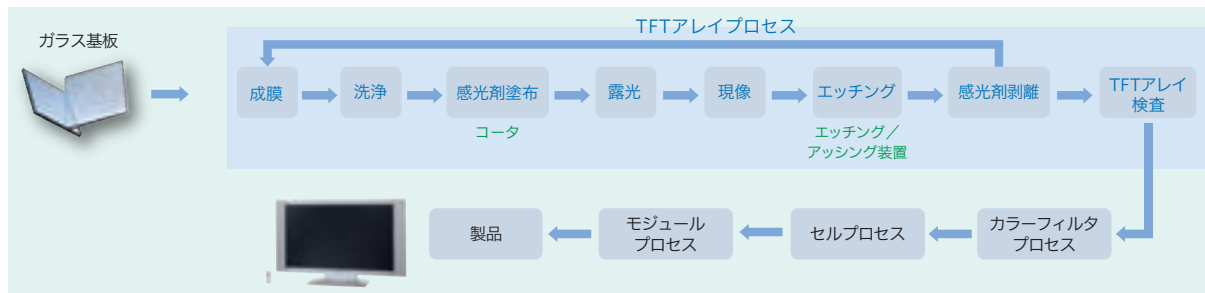
近年、半導体の微細化により後工程の重要性が増しており、当社グループでは当分野を強化し、装置ラインナップを拡充させています。



TFT-LCD製造プロセス

FPD製造の要となるTFTアレイプロセスは、半導体製造におけるウェーハ処理プロセスとほぼ同様の工程です。

※TFT…Thin Film Transistor（薄膜トランジスタ）



連結財務諸表

連結貸借対照表

(単位:百万円)

科目	期別	第52期中間期 (平成26年9月30日現在)	第51期 (平成26年3月31日現在)	増減
資産の部				
流動資産		593,210	621,492	△ 28,282
現金及び預金		48,641	56,345	
受取手形及び売掛金		102,012	129,032	
有価証券		250,480	211,800	
商品及び製品		84,279	114,289	
仕掛品		40,952	38,074	
原材料及び貯蔵品		17,053	15,912	
その他		50,602	57,538	
貸倒引当金		△ 813	△ 1,502	
固定資産		208,100	207,099	1,000
有形固定資産		111,636	112,344	△ 707
無形固定資産		27,667	29,556	△ 1,888
のれん		8,990	9,400	
その他		18,677	20,155	
投資その他の資産		68,795	65,199	3,596
その他		70,674	67,065	
貸倒引当金		△ 1,878	△ 1,866	
資産合計		801,310	828,591	△ 27,281

科目	期別	第52期中間期 (平成26年9月30日現在)	第51期 (平成26年3月31日現在)	増減
負債の部				
流動負債		145,710	170,509	△ 24,799
支払手形及び買掛金		39,885	53,667	
短期借入金		—	11,531	
未払法人税等		11,032	14,014	
製品保証引当金		10,778	10,072	
その他の引当金		7,813	8,642	
その他		76,200	72,581	
固定負債		59,723	67,468	△ 7,744
その他の引当金		374	582	
退職給付に係る負債		49,026	53,448	
その他		10,322	13,436	
負債合計		205,434	237,978	△ 32,544
純資産の部				
株主資本		572,484	559,679	12,805
資本金		54,961	54,961	
資本剰余金		78,023	78,023	
利益剰余金		448,647	436,174	
自己株式		△ 9,146	△ 9,478	
その他の包括利益累計額		21,675	18,411	3,264
その他有価証券評価差額金		5,555	5,592	
繰延ヘッジ損益		75	60	
為替換算調整勘定		9,976	5,777	
退職給付に係る調整累計額		6,068	6,981	
新株予約権		1,487	1,643	△ 156
少数株主持分		227	10,878	△ 10,650
純資産合計		595,876	590,613	5,262
負債純資産合計		801,310	828,591	△ 27,281

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書

(単位:百万円)

科目	期別	第52期	第51期	増減
		中間期 (平成26年4月1日から 平成26年9月30日まで)	中間期 (平成25年4月1日から 平成25年9月30日まで)	
売上高		294,273	254,500	39,773
売上原価		186,825	174,453	
売上総利益		107,448	80,046	27,401
販売費及び一般管理費		77,333	81,869	
研究開発費		34,951	38,440	
その他		42,381	43,428	
営業利益又は営業損失 (△)		30,115	△ 1,822	31,937
営業外収益		2,264	3,981	△ 1,717
受取利息		551	677	
補助金収入		478	907	
その他		1,233	2,397	
営業外費用		605	1,570	△ 964
為替差損		535	1,338	
その他		69	232	
経常利益		31,773	588	31,184
特別利益		175	98	76
固定資産売却益		120	79	
投資有価証券売却益		54	—	
その他		—	18	
特別損失		2,848	1,009	1,839
減損損失		—	873	
子会社株式売却損		1,609	—	
拠点再編費用		698	—	
その他		540	135	
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失 (△)		29,101	△ 321	29,422
法人税等		9,058	△ 2,903	
少数株主損益調整前当期純利益		20,042	2,582	17,460
少数株主利益		26	105	
当期純利益		20,016	2,476	17,539

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科目	期別	第52期	第51期	増減
		中間期 (平成26年4月1日から 平成26年9月30日まで)	中間期 (平成25年4月1日から 平成25年9月30日まで)	
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失 (△)		29,101	△ 321	
減価償却費		9,737	12,749	
のれん償却額		544	2,139	
退職給付引当金の増減額 (△は減少)		—	1,474	
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)		757	—	
子会社株式売却損益 (△は益)		1,609	—	
売上債権の増減額 (△は増加)		5,327	△ 16,352	
たな卸資産の増減額 (△は増加)		5,186	△ 20,314	
仕入債務の増減額 (△は減少)	△	6,535	9,058	
未収消費税等の増減額 (△は増加)		4,740	7,529	
前受金の増減額 (△は減少)		4,343	8,201	
その他		2,861	△ 6,975	
小計		57,671	△ 2,811	60,482
利息及び配当金の受取額		984	2,262	
利息の支払額	△	15	△ 39	
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△	15,302	371	
営業活動によるキャッシュ・フロー		43,338	△ 217	43,555
定期預金の増減額 (△は増加)		—	△ 48	
短期投資の増減額 (△は増加)		89,303	13,984	
有形固定資産の取得による支出	△	6,597	△ 5,246	
無形固定資産の取得による支出	△	128	△ 1,356	
投資有価証券の売却による収入		1,084	1	
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入		1,726	—	
その他	△	28	△ 186	
投資活動によるキャッシュ・フロー		85,358	7,148	78,210
短期借入金の純増減額 (△は減少)		—	4,101	
長期借入れによる収入		—	2,000	
配当金の支払額	△	6,272	△ 4,658	
その他	△	186	△ 339	
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 6,458	1,102	△ 7,561
現金及び現金同等物に係る換算差額	△	1,963	△ 2,158	194
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)		120,274	5,875	114,399
現金及び現金同等物の期首残高		104,797	85,313	19,483
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)		—	△ 1,206	1,206
現金及び現金同等物の期末残高		225,071	89,982	135,089
「現金及び現金同等物の期末残高」並びに短期投資等 合計額 (注2)		299,121	230,858	68,262

(注) 1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. 現金及び現金同等物に含まれていない満期日又は償還日までの期間が3ヵ月を超える定期預金及び短期投資を加えた残高を示しております。

会社の概況等

会社の概況 (平成26年9月30日現在)

商号	東京エレクトロン株式会社 TOKYO ELECTRON LIMITED
設立	昭和38年11月11日
資本金	54,961,191,468円
本社	東京都港区赤坂五丁目3番1号

主要な事業所

府中テクノロジーセンター	東京都府中市住吉町二丁目30番地の7
テクノロジーセンター仙台	宮城県仙台市泉区大沢三丁目2番地の1
大阪支社	大阪府大阪市淀川区宮原三丁目4番30号
山梨事業所 (藤井地区)	山梨県韮崎市藤井町北下条2381番地の1
(穂坂地区)	山梨県韮崎市穂坂町三ッ沢650番地
札幌事業所	北海道札幌市中央区南一条東一丁目5番
九州営業所	熊本県合志市福原1番地1

取締役・監査役 (平成26年9月30日現在)

代表取締役会長兼社長	東 哲郎
取締役副会長	常石 哲男
代表取締役副社長	北山 博文
取締役	伊東 晃
取締役	鷲野 憲治
取締役	原田 芳輝
取締役	堀 哲朗
取締役(社外)	井上 弘
取締役(社外)	坂根 正弘
常勤監査役	森 章次郎
常勤監査役(社外)	赤石 幹雄
監査役(社外)	山本 高稔
監査役(社外)	酒井 竜児

株主メモ

事業年度	4月1日から翌年の3月31日まで
定時株主総会	事業年度終了後3ヵ月以内
基準日	定時株主総会については、毎年3月31日 その他必要があるときは、あらかじめ公告する一定の日
単元株式数	100株
株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
(郵便物送付先) (電話照会先)	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社証券代行部 ☎ 0120-782-031 (フリーダイヤル)
単元未満株式の 買取請求取扱	お取引証券会社等 (特別口座で管理されている場合は特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社)
公告方法	電子公告 (電子公告アドレス (http://www.tel.co.jp/) ただし、電子公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載いたします。
上場金融商品取引所	東京証券取引所 市場第一部 (証券コード 8035)

配当金のお支払いについて

第52期第2四半期配当金は、同封の「配当金領収証」により、平成26年12月1日から平成27年1月16日までの間に、最寄りのゆうちょ銀行等でお受け取りください。金融機関預金口座振込・ゆうちょ銀行貯金口座振込をご指定の方には、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」のとおり、また、証券会社等の口座振込をご指定の方には、同封の「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」のとおり振込手続きをいたしましたので、ご確認ください。



TOKYO ELECTRON



UD
FONT

見やすく読みまちがえ
にくいユニバーサル
デザインフォントを採用
しています。